



附表 1

完成人合作关系说明

该项目产品研发过程由项目负责人李朴总体负责，成立研制团队。团队主要分六大部分：项目负责人、产品质量负责人、芯片设计负责人、项目管理、产品试验负责人及工艺流程设计。

项目负责人李朴全权负责项目的全流程管理，统筹项目策划、设计输入、设计输出、例行试验、用户试用、鉴定验收直至项目竣工验收各环节工作；产品质量负责人刘亚慧主要管控产品生产全周期质量管控工作，孙敬宇、李朴参与质量管控全过程，开展质量监督、问题复盘及闭环处理；芯片设计负责人赵安康负责版图设计，孙敬宇、李朴参与芯片设计全流程，配合开展方案评审、技术风险研判等工作；项目管理负责人唐康乐负责项目进度跟踪、项目资料归档、知识产权申报对接、内外部沟通协调等，项目负责人李朴跟踪项目管理过程；产品试验负责人孙敬宇牵头开展各项试验工作，刘亚慧和李朴参与试验过程监督，保障试验数据真实可靠；工艺流程设计负责人刘英负责芯片生产过程中的工艺流程设计，赵安康、李朴参与工艺流程风险把控。

所有团队成员分工明确、密切协同配合，共同完成本项目芯片设计、工艺开发、参数测试、可靠性试验及鉴定验收等全部研发任务，保障项目按计划高质量落地实施。

第一完成人签名：李朴



完成人合作关系情况汇总表

序号	合作方式	合作者/项目排名	合作起始时间	合作完成时间	合作成果	证明材料
1	项目负责人	李朴/1 刘亚慧/2 赵安康/3	2022. 4. 11	2024. 5. 10	完成鉴定验收	设计文件
2	产品质量负责人	刘亚慧/2 孙敬宇/5 李朴/1	2022. 4. 11	2024. 5. 10	完成鉴定验收	设计文件
3	芯片设计负责人	赵安康/3 孙敬宇/5 李朴/1	2022. 8. 1	2024. 5. 10	完成鉴定验收	设计文件
4	项目管理	唐康乐/4 李朴/1	2022. 9. 2	2024. 5. 10	完成鉴定验收	芯片订单
5	产品试验负责人	孙敬宇/5 刘亚慧/2 李朴/1	2023. 1. 5	2024. 5. 10	完成鉴定验收	试验大纲
6	工艺流程设计	刘英/6 赵安康/3 李朴/1	2022. 4. 11	2024. 5. 10	完成鉴定验收	设计文件

承诺：本人作为项目第一完成人，对本项目完成人合作关系及上述内容的真实性负责，特此声明。

第一完成人签名：李朴